

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（    ）
参与单位名称	2025 年 10 月 9 日 宝盈基金、碧云资本、大简投资、广发基金、汇丰晋信基金、嘉实基金、鹏华基金、易方达基金、中银基金等
时间	2025 年 10 月 9 日
调研方式	线上会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、董事会秘书、人事行政高级副总裁：石雯丽
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	
公司介绍	<p>芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。</p> <p>公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这</p>

六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。

基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AIPC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。

基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。

芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。此外，根据 IPnest 在 2025 年的统计，从半导体 IP 销售收入角度，芯原是 2024 年中国大陆排名第一、全球排名第八的半导体 IP 授权服务提供商；2024 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的报告和企业公开数据，在全球排名前十的 IP 企业中，芯原的 IP 种类排名前二。

根据公司《2025 年第三季度经营情况的自愿性披露公告》，公司预计 2025 年第三季度实现营业收入 12.84 亿元，单季度收入创公司历史新高，环比大幅增长 119.74%，同比大幅增长 78.77%；预计 2025 年第三季度盈利能力大幅提升，第三季度单季度亏损同比、环比均实现大幅收窄；预计 2025 年第三季度新签订单 15.93 亿元，同比大幅增长 145.80%，前

	<p>三季度新签订单 32.49 亿元，已超过 2024 年全年新签订单水平；公司在手订单已连续八个季度保持高位，预计截至 2025 年第三季度末在手订单金额为 32.86 亿元，持续创造历史新高。以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2025 年第三季度报告为准。</p>
<p>交流问答</p>	<p><b>问题：公司第三季度新签订单金额非常亮眼，请问主要是哪些类型的项目带动？</b></p> <p>回复：近年来，随着 AI 技术的快速发展，半导体产业迎来了高速增长长期。受益于 AI 浪潮，公司订单饱满，预计 2025 年第三季度新签订单 15.93 亿元，同比大幅增长 145.80%，其中 AI 算力相关的订单占比约 65%。公司预计 2025 年前三季度新签订单 32.49 亿元，已超过 2024 年全年新签订单水平。</p> <p>公司在手订单已连续八个季度保持高位，预计截至 2025 年第三季度末在手订单金额为 32.86 亿元，持续创造历史新高。公司 2025 年第三季度末在手订单中，一站式芯片定制业务在手订单占比近 90%，且预计一年内转化的比例约为 80%，为公司未来营业收入增长提供了有力的保障。</p> <p><b>问题：请问公司如何看待未来研发投入变化趋势？</b></p> <p>回复：芯原所处的集成电路设计行业，是集成电路产业的上游行业，相对产业链中其他行业而言，需要更早地进行针对性的布局和研发。因此集成电路设计行业呈现投资周期长，研发投入大的行业格局。通过 20 余年的高研发投入和深度积累，公司已经在半导体 IP 和芯片定制领域形成了丰富的技术池和服务经验。未来，随着公司芯片设计业务订单增加，预计未来公司会将更多研发资源投入客户项目，研发投入占营业收入比重将有所下降。</p>

**问题：请问公司如何看待 SerDes 领域的发展，未来是否有行业整合的规划？**

回复：随着数据中心对网络通信速度和性能需求的不断提升，高速接口技术也迎来关键发展时期，这其中最为关键的高速 SerDes 接口 IP 已经成为了近年来研究的热点。该接口 IP 实现了高速串行通信链路的升级，提供更多带宽和更高端口密度，提升数据中心效率，为大数据的持续发展奠定基础。

作为半导体 IP 和一站式芯片定制服务平台的行业龙头，芯原多年以来一直坚持以内部自主研发为主，在自主创新的同时适时对芯原所需的技术和团队进行准确的收购和引进、吸收再创新，在此过程中，芯原的 IP 得到了充实，芯片定制能力也逐渐变强。未来，公司将继续依托平台化公司的行业理解，积极推进产业生态建设，视业务需要择机进行与公司战略发展方向相一致的投资或并购公司，并将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

**问题：请问公司在端侧 AI 领域的计算布局和客户合作项目有哪些？**

回复：基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。在端侧，我们积极布局智慧汽车、AR/VR 等增量市场，已经为多家国际行业巨头客户提供了技术和服 务。目前，集成了芯原 NPU IP 的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货近 2 亿颗，主要应用于物联网、可穿戴设备、智慧电视、智慧家居、安防监控、服务器、汽车电子、智能手机、平板电脑、智慧医疗等 10 个市场领域，在嵌入式 AI/NPU 领域全球领先，芯原的 NPU IP 已被 91 家客户用于上述市场领域的超过 140 款 AI 芯片中；在 AR/VR 眼镜领域，公司已为某知名国际互联网企业提供

AR 眼镜的芯片一站式定制服务，此外还有数家全球领先的 AR/VR 客户正在与芯原进行合作。

**问题：请问公司在 Chiplet 技术上有哪些布局？**

回复：Chiplet 技术及产业化是芯原的发展战略之一，目前，公司正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的发展和产业化，持续提升公司半导体 IP 授权和芯片定制业务的产业价值，拓展市场空间。

公司已在基于 Chiplet 的生成式人工智能大数据处理和高端智驾两大赛道实现领跑，目前正在推进基于 Chiplet 架构、面向智驾系统和 AIGC 高性能计算的芯片平台研发项目。目前公司已帮助客户设计了基于 Chiplet 架构的 Chromebook 芯片，采用了 SiP（System in Package）先进封装技术，将高性能 SoC 和多颗 IPM 内存合封；帮助客户的 AIGC 芯片设计了 2.5D CoWoS 封装；已设计研发了针对 Die to Die 连接的 UCIe 物理层接口，相关测试芯片已完成流片，正在实验室进行测试，目前进展顺利；已和 Chiplet 芯片解决方案的行业领导者合作，为其提供包括 GPGPU、NPU 和 VPU 在内的多款芯原自有处理器 IP，帮助其部署基于 Chiplet 架构的高性能人工智能芯片，该芯片面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。此外，为了应对先进封装技术可能出现的供应和成本等问题，芯原已针对新一代面板级封装（Panel level package）技术进行了先行设计开发，为接下来的规模量产做好了准备。本土封装厂也正在积极布局该封装技术，芯原将与之携手，共同打造更具成本效益且供应安全的先进封装解决方案。